

Cietēšanas laiks ar halogēnu vai LED cietēšanas
1:1 maisījuma ar ENA BOND KATALIZATORU 40 sek.
saistīšanās laiks pašsacietēšanai bez gaismas, gaisa izslēgts apm. 3 min.
(sk. ENA BOND KATALIZATORA pamācību)

MSDS pieejama tīmekļa vietnē: www.micerium.com



MICERIUM S.p.A. Via G. Marconi 83 16036 Avegno (GE) Itālija
Tel. +39-0185-7887870 Fakss: +39-0185-7887970
www.micerium.it e-pasts: micerium@micerium.it
Eksporta tiešā linija: Tālr. +39-0185-7887880 e-pasts: hfo@micerium.it

ENA BOND (LV) Vienkomponenta saite

Informācija par produktu

ENA BONDEN ir spēcīga dentīna-emaļjas savienojuma sistēma, kas sastāv no vienkomponeņa gaismā cietējoša materiāla, kas vienlaicīgi ir primers un adhezīvs

ENA BOND ir paredzēta stiprai kompozītmateriālu, kompomēru un metālu saītēšanai pie emaljas un dentīna, kā arī nedārgmetāliem un dārgmetāliem.

ENA BOND var izmantot arī sakņu kanālu gruntēšanai pirms sakņu kanālu aizpildīšanas vai endodontisko tapu cementēšanai.

ENA BOND ir papildus izstrādāta kā grunts līmējošam cementam netiešai rekonstrukcijai, piemēram, keramikas, metāla un kompozītmateriālu inlejiem, onlejiem, venīriem, kroņiem un tiltiem ar pašsacietējošu vai divkāršu sacietējošu kompozīto cementu.

ENA BOND nodrošina ilgstošu savienojumu stiprību un labu bioloģisko saderību.

ENA BOND ir saderīgs ar visiem gaismā cietējošiem kompozītmateriālu zīmoliem.

ENA BOND ir veidots uz etanola bāzes. Tā kā tas ir hidrofilis, ENA BOND var izmantot uz nedaudz mitrām dentīna virsmām (mitrās savienošanas metode).

Retos gadījumos ir ieteicama duāla vai pašcietējoša gruntēšanas un līmēšanas sistēma. ENA BOND var iegūt duālu sacietēšanu, ja to uzklāj ENA BOND un **ENA BOND KATALIZATORA** maisījuma proporcijā 1:1. Aktivators ir pieejams atsevišķi. Par šiem lietojumiem skatīt ENA BOND KATALIZATORA lietošanas rekomendācijas.

ENA ETCH ir kodināšanas gēls sarkanā krāsā (37% fosforskābe).

Indikācijas

- līme tiešai restaurācijai ar gaismā sacietējošu kompozītu

- līme netiešai keramikas vai kompozītai restaurācijai (inleji, onleji, venīri)

Kontrindikācijas

Ja pacientam ir zināmas alerģijas vai paaugstināta jutība pret šī produkta sastāvdaļu, mēs iesakām to neizmantot vai darīt to tikai stingrā medicīniskā uzraudzībā. Šādos gadījumos mēs pēc pieprasījuma piegādāsim mūsu medicīnas ierīces sastāvu. Pirms zāļu lietošanas zobārstam jāapsver zināma zāļu mijiedarbība un krusteniskās reakcijas ar citiem materiāliem, kas jau ir pacienta mutē.

ENA BOND vienkomponeņa: lietošanas instrukcijas

1. GAISMĀ CIETĒJOŠU KOMPOZĪTO RESTAURĀCIJU SAVIENOŠANA

Lateksa ieliktnis ir ieteicamā izolācijas metode. Sagatavojiet dobumu ar minimālu zoba samazinājumu. Apstrādājiet tikai tās vietas, kas atrodas tiešā mikstuma tuvumā, izmantojot cieti sasaistošo kalcija-hidroksīda materiālu, ko pārklāj ļoti plāns stikla jonomēra slānis (daži autori izvairās no šī fragmenta). Uzklājiet ENA ETCH kodināšanas gelu uz visa dobuma (emaljas un dentīna-kopējā kodināšanas metode). ENA Etch kodināšanas gelu atstāj uz 15 sekundēm. Noskalojiet un uzklājiet to vēlreiz tikai uz emaljas malām vēl uz 20 sekundēm. Izskalojiet un nožāvējiet ar eļļu un ūdeni nesaturošu gaisu, atstājot dentīnu slapju (slapjā metode).

KODINĀŠANAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI: Ir svarīgi, lai kodinātā emalja un dentīns netiktu piesārņoti ne ar ko, citādi kodināšanas process jāatkārto. Bīstamības paziņojumi: izraisa nopietnus ādas apdegumus un acu bojājumus. Piesardzības paziņojumi: āda (vai mati) nekavējoties novilkt visus piesārņotos apģērbus. Mazgāt ar ūdeni. Acis: Uzmanīgi vairākas minūtes skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas un turpiniet skalot. Nekavējoties zvaniet saīndēšanās centram / ārstam. Uzklājiet atbilstošu daudzumu ENA BOND ar birsti vai ar nelielu sūkli (Ena Bond aplikatoru) uz dentīna-emaļjas virsmām uz 20-30 sekundēm, pārklājiet ar gaisu, kas nesatur eļļu vai ūdeni, 40 sekundes sacietējiet visu virsmu ar halogēna / LED cietināšanas bloku. Papildus otrā Ena Bond kārta jāuzklāj, ievērojot to pašu augstākminēto procedūru. Pēc tam uzklājiet pildījuma materiālu (skatīt *ENA HRI / Enamel plus HRI* norādījumus).



2. PĀRKLĀŠANA AR JAVU PĒC TAM AR LĪMI METODI

Stingri ieteicams izmantot lateksa koferdamu, lai izolētu zobu. Sagatavojiet un iztīriet sakņu kanālu; dobuma virsmu mikrostrūklošana ir ieteicama, lai notīrītu un likvidētu endodontisko materiālu atliekas. 2 minūtes kodiniet dobumu ar Ena Etch 37% fosforskābi. Precīzi izmazgājiet kanālu ar šļirci, lai pilnībā noņemtu skābi. Izsūciet ūdeni un izžāvējiet kanālu ar papīru; lai uzturētu dentīnu slapju un izvairītos no kolagēna sabrukšanas, nežāvējiet kanālu un gaisu. Iekļājiēt dobumā un kanālā Ena Bond un Ena Bond katalizatora maisījumu, lai padarītu to duālu, lai nodrošinātu pilnīgu polimerizāciju. Lime jānoslauka no virsmas, izmantojot vienreizlietojamo mikrobirsti vai papīra štiftu; **Uzmanību:** Nodrošiniet, ka mikrobirste sasniedz kanāla dziļumus un ka Bonder tiek vienmērīgi berzēts visās vietās. Mikrosuka nedrīkst pieskarties virsmai vai iesprūst. Žāvēt ar papīru; lai likvidētu ūdens un šķīdinātāja atliekas. Ievietojiet tapu, lai pārbaudītu kanālu un labāk iespiestu limi dentīna tubulās. Iekļājiēt kanālā duālo kompozīta cementu. Uzklājiēt uz tapas virsmas nedaudz cementu un lēnām ievietojiet tapu visā dziļumā. Sacietēšana gaismā uz 60 sekundēm un turpināt ar atjaunošanu. Par tapas ievietošanu un kompozīta cementa sacietēšanu skatīt ražotāju norādījumus (sk. Ena Post un Ena Cem instrukcijas).

3. DOBUMA HERMETIZĒŠANA PIRMS AMALGAM PIEPILDĪŠANAS RESTAURĀCIJAS

Sagatavojiet dobumu, kodiniet, mazgājiet un uzklājiēt limi. Svarīgi: šādās klīniskās situācijās, lai būtu pārliecināts par pilnīgu polimerizāciju, ENA BOND jāsauc ar ENA BOND KATALIZATORU, lai izveidotu duālu maisījumu. 40 sekundes sacietējiēt savienojumu ar halogēna / LED sacietēšanas bloku. Papildus otrā Ena Bond kārtā jāuzklājiēt, ievērojot to pašu augstākminēto procedūru. Uzklājiēt amalgamu, ievērojot ražotāja norādījumus.

Piezīme: Limēšanas sveķi nesacietēs bez atbilstoša katalizatora. Ja to neizlieto uzreiz, novietojiet izspiesto limi vājinātā gaismā, lai novērstu priekšlaicīgu polimerizāciju ar kritošu gaisu.

ENA BOND katalizators: lietošanas instrukcijas

Ena Bond katalizators ir piedeva, kas tiek vienkārši sajaukta ar Ena Bond, lai pārvērstu to par duālu sacietēšanas vai pašsacietēšanas grunti un limēšanas sistēmu.

1. NETIEŠAS RESTAURĀCIJAS UZKLĀŠANA

Sagatavojot un kodinot dobumu, ievērojiet Ena Bond savienošanas norādījumus.

- [Ena Bond saistvielas un Ena Bond katalizatora sagatavošana un uzklāšana](#)

Kad dobums ir sagatavots, ievietojiet maisīšanas dobumā vienu pilienu *Ena Bond saistvielu*. Pievienojiet vienu pilienu *Ena Bond Katalizatoru* un sajauciet 15 sekundes vājinātā gaismā.

- [Uzklāšana uz dentīna un emaljas](#)

Uzklāj uz dentīna un emaljas virsmām pietiekamu daudzumu *Ena Bond saistvielas* un *Ena Bond katalizatora* maisījumu un 30 sekundes enerģiski apstrādājiēt ar birstīti, lai izveidotu viendabīgu pārklājumu. Atkārtoti uzklājiēt maisījumu, lai nodrošinātu, ka dentīna un emaljas virsmas tiek uzturētas mitras nepieciešamo laiku ar maisījumu. Pēc tam uzmanīgi žāvējiēt apmēram 15 sekundes ar eļļu nesaturošu saspiestu gaisu. 20 sekundes sacietējiēt *Ena Bond saistvielu/Ena Bond katalizatoru* kārtu ar halogēna/LED sacietināšanas bloku, pirms uzklāt otro kārtu (skatīt nākamo punktu).

- [Otrās kārtas uzklāšana](#)

Otro kārtu uzklāj, 30 sekundes enerģiski apstrādājiēt ar birstīti pietiekamu daudzumu duālās sacietēšanas *Ena Bond saistvielas/Ena Bond katalizatora* maisījumu. Pēc tam virsmu atkal žāvē aptuveni 15 sekundes ar eļļu nesaturošu saspiestu gaisu un 20 sekundes sacietē ar sacietēšanas gaisu. Ir ļoti svarīgi, lai virsmas paliek sausas un tīras, līdz tiek uzlikta netiešā restaurācija. Šī dubultās sacietēšanas sistēma automātiski sacietē 3 minūšu laikā pēc tās uzklāšanas un netiešās restaurācijas uzlikšanas.

- [Netiešās restaurācijas lutēšana](#)

Skatīt *ENA HRI / Enamel Plus HRI* lietošanas instrukcijas.

2. PAŠSACIETĒJOŠO UN DUĀLI SACIETĒJOŠO KOMPŪZĪTU VAI KOMPOMĒRU SASAIŠTĪŠANA

- [Dobuma sagatavošana un Ena Bond saistvielas/Ena Bond katalizatora uzklāšana](#)

Kad dobums ir sagatavots, kā aprakstīts sadaļā *Ena Bond saistviela*, ievietojiet maisīšanas dobumā vienu pilienu *Ena Bond saistvielu*. Pievienojiet vienu pilienu *Ena Bond Katalizatoru* un sajauciet 15 sekundes vājinātā gaismā.

- [Uzklāšana uz dentīna un emaljas](#)

Uzklāj uz dentīna un emaljas virsmām pietiekamu daudzumu *Ena Bond saistvielas* un *Ena Bond katalizatora* maisījumu un 30 sekundes enerģiski apstrādājiēt ar birstīti, lai izveidotu viendabīgu pārklājumu. Atkārtoti uzklājiēt maisījumu, lai nodrošinātu, ka dentīna un emaljas virsmas tiek uzturētas mitras nepieciešamo laiku ar maisījumu. Pēc tam uzmanīgi žāvējiēt apmēram 15 sekundes ar eļļu nesaturošu saspiestu gaisu. 20 sekundes sacietējiēt *Ena Bond saistvielu/Ena Bond katalizatoru* kārtu ar halogēna/LED sacietināšanas bloku, pirms uzklāt otro kārtu (skatīt nākamo punktu).

- [Otrās kārtas uzklāšana](#)

Otro kārtu uzklāj, 30 sekundes enerģiski apstrādājiēt ar birstīti pietiekamu daudzumu *Ena Bond saistvielas/Ena Bond katalizatora* maisījumu. Žāvējiēt laukumu apmēram 15 sekundes ar eļļu nesaturošu saspiestu gaisu. Ir ļoti svarīgi, lai šīs virsmas paliek sausas un tīras, līdz tiek uzklāts ķīmiskais vai duālās sacietēšanas kompozīts vai kompomērs. Divkārtšās sacietēšanas sistēma sacietē aptuveni 3 minūšu laikā pēc uzklāšanas un ķīmiskā vai divkārtšās sacietēšanas pildījuma materiāla ievietošanas. Lai samazinātu sacietēšanas laiku, duālās sacietēšanas aizpildīšanas materiālu var sacietināt ar lampu.

- [Pildījuma lutēšana](#)

Skatiet ķīmiskā vai duālās sacietēšanas kompozīta/kompomēra ražotāja norādījumus.

Svarīgas piezīmes

Ena Bond ir vienkomponeņa emaljas-dentīna saistviela uz etanola bāzes, kas ir netoksiska un tomēr gaistoša. Tāpēc tā ļauj koncentrēt atšķaidītās sastāvdaļas, lai izveidotu labu savienojumu starp dentīnu / emalju un kompozītu. Viena no galvenajām *Ena Bond* formulas daļām ir metakrīlekarbonskābes esteri. Šie materiāli izstrādā maksimālās sasaistīšanas vērtības mitros apstākļos. Tas ir nepieciešams, jo dentīns vienmēr satur noteiktu daudzumu fizioloģisko šķidrumu. Galvenais, lai iegūtu maksimālās sasaistīšanas vērtības, ir pareizs *Ena Bond* uzklāšanas veids. Materiāls ir jāuzklāj ar nelielu suku uz dentīna un emaljas virsmām. Saistviela jāiemasē dobumā vismaz 30 sekundes. Jāpārliecinās, ka gan dentīna, gan emaljas visa virsma ir mitra un pārklāta ar *Ena Bond*. Nedrīkst būt lieki šķidrums daudzumi. Kad ir uzklāta plāna materiālu kārtā ar otu vismaz 30 sekundes, virsma vismaz 15 sekundes ir rūpīgi jānožāvē ar gaisa plūsmu no zobārsta krēsla (bez eļļas). 40 sekundes sacietējiēt *Ena Bond* ar spēcīgu halogēna lampu / LED sacietināšanas bloku. Papildus otrā *Ena Bond* kārtā jāuzklāj, ievērojot to pašu augstākminēto procedūru. Pēc gaismas sacietēšanas procesa *Ena Bond* virsma joprojām ir mitra, nevis cieta plēve. Pēc kompozītmateriāla uzklāšanas uz mitrās virsmas, *Ena Bond* kopā ar kompozītmateriālu izstrādā optimālās savienošanas vērtības skābekli nesaturošos apstākļos. Augstāk aprakstītie norādījumi ir ļoti svarīgi, un tie ir rūpīgi jāievēro.

Papildu piezīmes: Nelietojiet sveķus vai šķidrums, lai pielāgotu limvielas viskozitāti. Neglabājiēt limes materiālu eigenola saturošu produktu tuvumā, kā arī neļaujiet limvielai nonākt saskarē ar materiāliem, kas satur eigenolu. Eigenols var pasliktināt limes sacietēšanu un izraisīt krāsas maiņu. Jāizvairās no limes saskares ar ādu, seviski, ja ir zināmas alerģijas pret sveķiem. Lietošana istabas temperatūrā (20°C/68°F-25°C/77°F). Tikai profesionālai dentālai lietošanai.

Bīstamības paziņojumi

Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Piesardzības pasākumu paziņojumi

Lietot aizsargcimdus/aizsargapģerbu/acu aizsarglīdzekļus/sejas aizsarglīdzekļus.

JA UZ ĀDAS (vai matiem): Nekāvējoties noņemiet/novelciet visus piesārņotos apģērbus. Noskalot ādu ar ūdeni/dušu.

JA ACĪS: Uzmanīgi vairākas minūtes skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu.

Uzglabāšana: Uzglabāšanas laiks ir 3 gadi, ja uzglabā temperatūrā no 3°C līdz 25°C (38°F - 77°F) grādiem.

Tehniskie dati

Saite starp dentīnu un kodinātu emaljas

30 MPa

Saite uz nedārgmetāliem (Co/Cr)

24 MPa

Saite uz dārgmetāliem (Au/Pd)

6 MPa